

Bio-mc:434

【演題募集】第 6 回日本ースイス・バイオメカニクス・ワークショップ(JSB2023)

バイオエンジニアリング部門
メーリングリスト登録者各位

昨年 12 月にご案内の通り、第 6 回日本ースイス・バイオメカニクス・ワークショップ
(6th Japan-Switzerland Workshop on Biomechanics, JSB2023)が
2023 年 8 月 29 日(火)～9 月 1 日(金)にグランドパーク小樽(北海道小樽市)にて
開催されます。

現在、アブストラクトの募集(締切:2023 年 3 月 17 日(金))を開始いたしましたので
ご案内申し上げます。申込方法の詳細は会議 HP をご覧下さい。

<https://www.jsme.or.jp/conference/jsb2023/index.html>

また、会議登録料およびホテル宿泊費(グランドパーク小樽)について併せてご案内
申し上げます。

会議登録料(見込み、今月中を目処に fix いたします。):

一 般	50,000 円
学 生	30,000 円
同伴者	30,000 円

※登録料には、コーヒーサービス(8/29 - 9/1)、ウェルカムディナー(8/29)、パン
ケット(8/30)、

フェアウェルディナー(8/31)、ランチ(8/30 - 9/1)、エクスカーション(8/31)が含まれま
す。

宿泊費:

シングル	12,320 円
ダブル	後日ご案内
トリプル	後日ご案内

※宿泊費は、朝食、税・サービス料を含む 1 泊 1 名当りの料金です。

重要な日程:

アブストラクト申込締切 2023 年 3 月 17 日(金)

参加申込・ホテル予約締切 2023年4月28日(金)
会議登録料・宿泊費支払締切 後日ご案内

皆様の研究発表および参加申込を心よりお待ちしております。
よろしくお願い申し上げます。

Co-Chairs:

大橋 俊朗, 北海道大学, [Email: ohashi@eng.hokudai.ac.jp](mailto:ohashi@eng.hokudai.ac.jp)

Philippe K. Zysset, University of Bern, [Email: philippe.zysset@artorg.unibe.ch](mailto:philippe.zysset@artorg.unibe.ch)

転送されたメッセージ:

差出人: Toshiro OHASHI <ohashi@eng.hokudai.ac.jp>

件名: 第6回日本ースイス・バイオメカニクス・ワークショップ(2023年8月29日(火)
～9月1日(金)、グランドパーク小樽)

日付: 2022年12月5日 16:57:53 JST

宛先: bio-mc@jsme.or.jp

バイオエンジニアリング部門
メーリングリスト登録者各位

第6回日本ースイス・バイオメカニクス・ワークショップ (6th Japan-Switzerland
Workshop on

Biomechanics, JSB2023)の開催につきましてご案内申し上げます。本ワークショップ
は新型コロナ

ウイルス禍のため、当初予定しておりました2020年から3年間にわたり延期してま
いりましたが、

下記の要領にて対面実施として開催することといたしました。

日 程: 2023年8月29日(火)～9月1日(金)、4日間

会 場: グランドパーク小樽(北海道小樽市築港11-3) ※会場は変更になりました。

会議 HP: <https://www.jsme.or.jp/conference/jsb2023/index.html>

ホームページは随時更新してまいります。registration など重要な情報は改めてご
案内申し上げます。

皆様におかれましては是非ご予約いただければ幸いです。
どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

Co-Chairs:

大橋 俊朗, 北海道大学, [Email: ohashi@eng.hokudai.ac.jp](mailto:ohashi@eng.hokudai.ac.jp)

Philippe K. Zysset, University of Bern, [Email: philippe.zysset@artorg.unibe.ch](mailto:philippe.zysset@artorg.unibe.ch)

大橋 俊朗 (Toshiro Ohashi)

北海道大学大学院工学研究院機械・宇宙航空工学部門

北海道大学欧州オフィス (ヘルシンキ)

〒060-8628 札幌市北区北 13 条西 8 丁目

Tel/Fax: 011-706-6424

[E-mail: ohashi@eng.hokudai.ac.jp](mailto:ohashi@eng.hokudai.ac.jp)
